

新製品紹介

カーエアコン用パワーMOSFETアッシー

本製品は、オートカーエアコンの風量調整に用いられるモジュールで、MOS形FET素子を主体とする制御回路と素子から発生した熱を逃がすヒートシンクで構成されており、クーラーユニットダクト内等に設置されてファンモータへの電流を制御する。

このモジュールの性能を向上させるために、本製品のヒートシンクには、以下の特徴がある。

特徴

1. ヒートシンク材料として従来のダイキャスト材

よりも熱伝導率の高い合金を採用した。

2. ダイキャストヒートシンクでは困難とされた高背フィンの薄肉化、狭ピッチ化を実現して、フィン枚数を増やし、放熱性を上げた。

その結果、表1に示すように、モジュールの温度上昇を従来品より大幅に下げている。このことは、逆に同じ温度上昇幅ならばヒートシンクを小さくすることになり、自動車部品の小型化、軽量化に寄与するものである。

図1に製品外観を示す。

(機器電材事業部電装品技術部 畑田)

表1 放熱性

品 種	温度上昇 T (参考値)
本製品	75~80
従来品	100

注：従来品を100とした比率・当社比

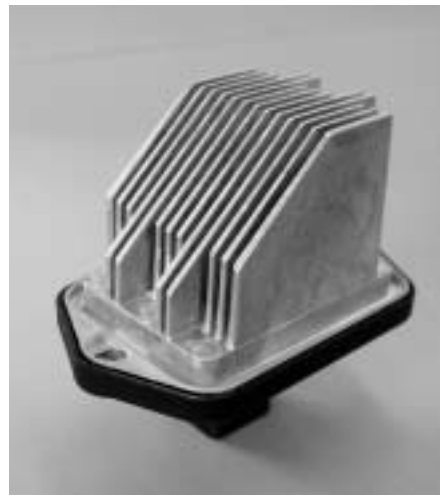


図1 MOSFETアッシー外観

〔お問い合わせ〕

機器電材事業部電装品技術部第三課

TEL 03-5606-1222 FAX 03-5606-1538

E-mail : syagi@fujikura.co.jp